

(비공식 번역본)

투자위원회 고시

제Sor.4/2567호

4.2.4 회로 기판 및/또는 부품 제조 활동에 대한 개정

2022년 12월 8일자 투자위원회 고시 제9/2565호『국가 개발을 위한 주요 산업에 대한 투자 유치 방안』에 따라, 태국 및 외국인이 운영하는 PCB 제조업체, 생산 공정에 사용되는 원재료 및 필수 재료 생산자, 공급망의 중요한 부분인 서비스 제공자 등을 포괄하여, 태국 내 PCB 산업 클러스터를 구축하고 개발하는 것을 목표로 인쇄회로기판(PCB: Printed circuit board) 제조 투자를 촉진하고자 한다. 불기 2020년(서기 1977년) 투자촉진법 제16조에 따라 투자청은 2022년 12월 8일자 투자위원회 고시 제9/2565호에 첨부된 리스트에 기재된 4.2.4의 활동을 폐지하고 다음의 내용으로 대체한다.

활동	조건	인센티브
4.2.4 회로기판, 원재료 또는 회로기판용 필수 재료 생산		
4.2.4.1 고밀도 상호연결 회로기판(HDI: High Density Interconnect) 생산	위원회의 승인에 따른 기계와 제조 공정에 대한 투자가 이루어져야 한다.	A2
4.2.4.2 연성회로기판과 다층 회로 기판 제조에 대한 대규모 투자	1. 제조공정에 사용되는 기계에 대한 자본투자(설치 및 시험운영 비용 포함)는 최소 15억 바트 이상 이어야 한다. 2. 프로젝트에 회로를 형성하는 공정(circuit trace manufacturing process)이 포함되어야 한다.	A2
4.2.4.3 연성회로 기판, 다층회로 기판의 제조	프로젝트에 회로를 형성하는 공정(circuit trace manufacturing process)이 포함되어야 한다.	A3
4.2.4.4 인쇄회로기판의 제조	프로젝트에 회로를 형성하는 공정(circuit trace manufacturing process)이 포함되어야 한다.	B
4.2.4.5 인쇄회로기판 제조를 지원하기 위한 핵심 공정에서의 서비스 제공	1. 다음 공정에서 최소 한가지 공정은 프로젝트에 포함되어야 한다.	

	<ul style="list-style-type: none"> - 라미네이션(lamination) - 드릴링(drilling) - 도금(Plating) - 라우팅(Routing) 	
	2. 제조공정에 투입되는 기계에 대한 투자(설치 및 테스트 실행 비용 포함)가 10억 바트 이상인 경우	A4
	3. 기타 경우	B
4.2.4.6 동박적층판(CCL: Copper Clad Lamination), 연성동박적층 필름(FCCL: Flexible Copper Clad Laminate), 프리프레그(Preoregs) 등 인쇄회로기판 제조에 중요한 원료 제조	1. 제조공정에 투입되는 기계에 대한 투자(설치 및 테스트 실행 비용 포함)가 15억 바트 이상인 경우	A2
	2. 기타 경우	A3
4.2.4.7 드라이 필름, 전사 필름, 백업 보드 등 인쇄회로기판의 원재료 또는 필수 재료의 제조		B

본 고시는 효력이 즉시 발생한다.

고시일 2024년 4월 22일

뽀뽀리 파히타누껀(Parnpree Bahiddha-Nukara)

(Mr.Parnpree Bahiddha-Nukara)

부총리

투자위원회 의장